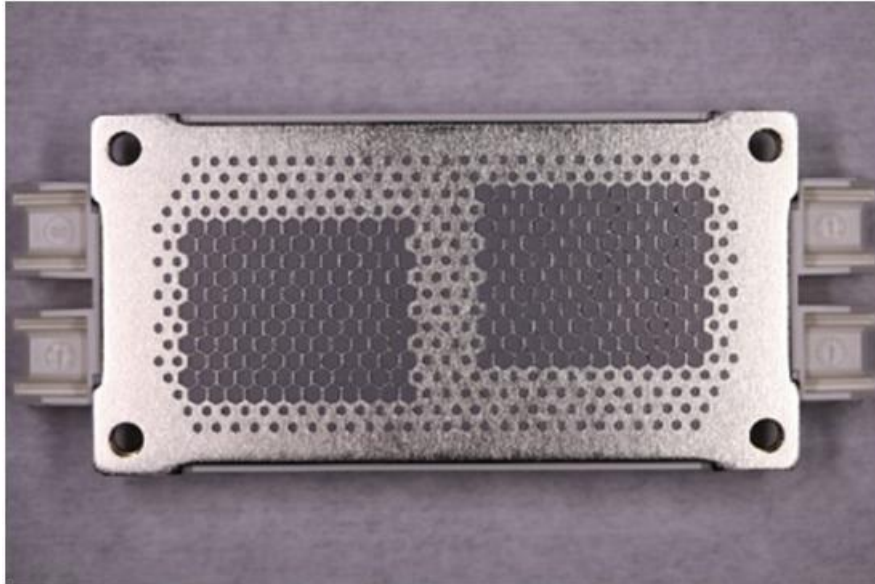


## LoPak von Hitachi ABB: Jetzt auch mit 1200V- IGBTs bis 2x900A und vorappliziertem TIM



Modul- Bodenplatte mit TIM

Das neue LoPak mit 1200 V IGBTs ist jetzt verfügbar. Es ergänzt das bestehende LoPak-Portfolio nun durch 1200V IGBTs mit Strömen von 2 x 600A und 2 x 900 A. Durch sein kompaktes und optimiertes Hochleistungsdesign kann es in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden.

Einige Highlights des Moduls sind:

- Vorappliziertes TIM (Thermal Interface Material), das zur Erhöhung der Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer beiträgt
- Bestückt mit der neuesten Generation extrem verlustarmer, robuster TSPT Trench-IGBT-Chips und dazu passend optimierten FSA-Freilaufdioden
- Fähigkeit zum Schalten höherer Stromdichten unter Verwendung eines optimierten Arbeitspunkts mit idealen Eigenschaften für alternative Energien (Wind und PV) und industrielle Anwendungen (Motorsteuerungen)
- Eine Aufrüstung neuer und bestehender Anwendungen zu höheren Leistungen ist möglich ohne daß Änderungen der mechanischen Konstruktion erforderlich werden
- Es hat Preß-Fit Pins für die Hilfs- und Steuerkontakte
- Die maximal zulässige Chiptemperatur beträgt 175 °C

Bei Fragen zu oder Interesse an diesem Modul sprechen Sie uns bitte an.